

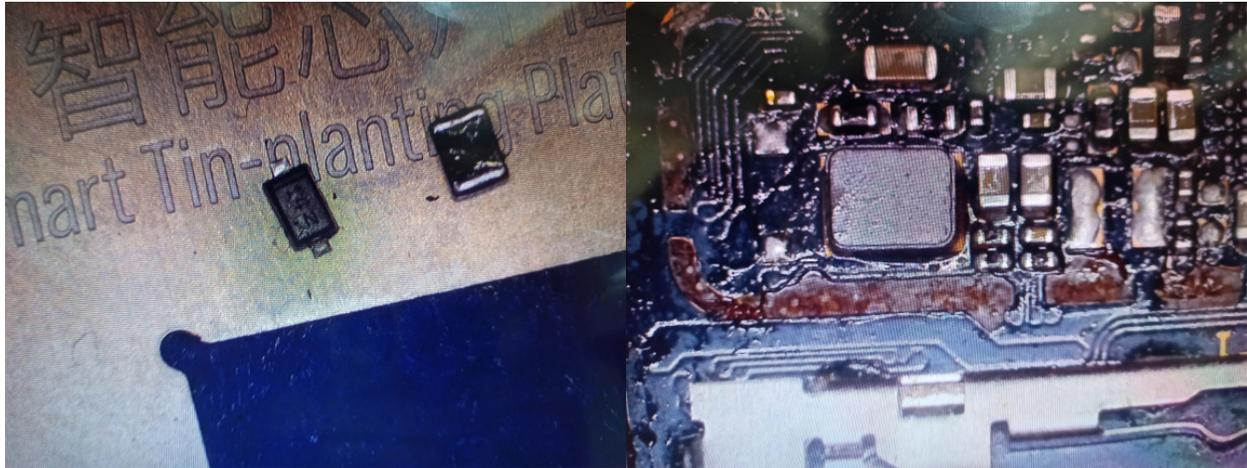
Tarea 8 del curso de Electrónica de Jianling Feng.

Realizar prácticas de microsoldadura y reballing utilizando las técnicas explicadas en las clases:

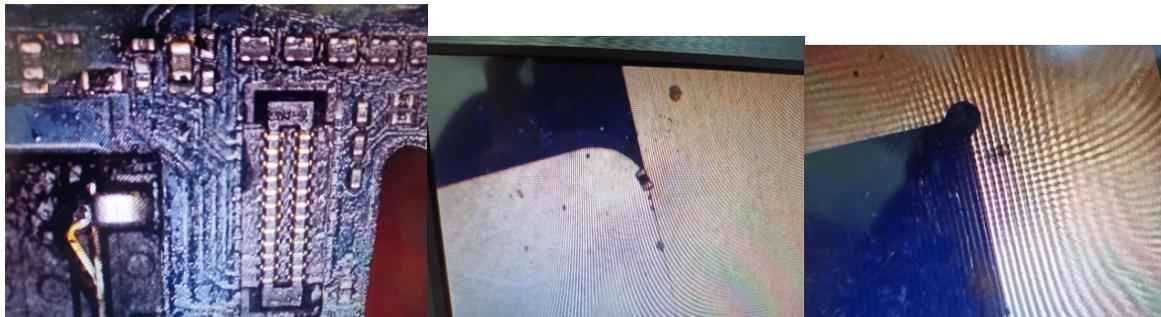
Samsung a115m - A11

Extraer componentes varios (Resistor, condensador, bobina, diodo) cercano a algun conector plástico sin causar daños visibles.

Diodo y bobina cercanos al Cpu:



Resistor y condensador cercanos al conector de camara trasera:



Extraer Mic superficial, Pulsador de volumen o de encendido y puerto de carga utilizando solo el cautin.





Realizar limpieza de resina negra y transparente anota la temperatura y aire empleado.



Haga la extraccion, limpieza y reballing de un ic sin resina.





Haga la extraccion, limpieza y reballing de un ic con resina.

Profe no tengo ic con resina solo cpu, ran y ROM de mi propiedad y otros que son viejos sin resina

Haga la extraccion, limpieza de un ic con resina utilizando cautin.

Tomar las fotos o videos de cada proceso y etiquetar a @OptimusRepair